

華邦電子股份有限公司

WINBOND ELECTRONICS CORP.

公開說明書

(發行一〇七年度第一次有擔保普通公司債申報用稿本)

一、公司名稱：華邦電子股份有限公司

二、本公開說明書編印目的：發行一〇七年度第一次有擔保普通公司債

三、發行公司債之種類、金額、利率及發行條件：

(一)發行種類：華邦電子股份有限公司一〇七年度第一次有擔保普通公司債(以下簡稱「本公司債」)

(二)發行金額：本公司債發行總額為新臺幣壹佰億元整，每張票面金額為新臺幣壹佰萬元整。

(三)發行期間及方式：本公司債為七年期，依票面金額十足發行。

(四)計付息方式：本公司債自發行日起，於每屆滿周年之日依票面利率每一年單利計、付息一次。每壹佰萬元債券付息至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。

(五)票面利率：本公司債票面利率為固定年利率1%。

(六)發行條件：除上述(一)~(五)外，還本方式為自發行日起屆滿七年期一次還本。擔保方式為有擔保普通公司債；債券形式採無實體發行，請參閱本公開說明書第2頁。

(七)公開承銷比例：100%委由承銷商對外公開銷售。

(八)承銷及配售方式：採餘額包銷方式，並以洽商銷售方式對外公開承銷。

(九)銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。

四、本次資金運用計劃之用途及預計可能產生效益之概要：本次發行有擔保普通公司債係用於支付資本支出、償還銀行借款及充實營運資金，可改善財務結構、降低銀行借款依存度，及提升產品產能達成經濟規模以強化公司競爭優勢，預計可能產生效益請參閱本公開說明書第3~5頁。

五、本次發行之相關費用：

(一)承銷費用：新臺幣壹仟萬元。

(二)其他費用(主要包括會計師、律師等費用)：約新臺幣壹拾參萬元。

六、有價證券之生效，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。

七、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。

八、投資人投資前應至金融監督管理委員會指定之資訊申報網站詳閱本公開說明書之內容，並應注意公司之風險事項。

九、本公司普通股股票面額為每股新臺幣壹拾元整。

十、查詢本公開說明書之網址：

(一)公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>

(二)公司資訊揭露之網址：<https://www.winbond.com>

華邦電子股份有限公司 編製

中華民國一〇七年七月四日刊印



一、本次發行前實收資本之來源，包括現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資及其他來源之金額與各占實收資本額之比率：

單位：新臺幣仟元；%

實收資本來源	金額	佔實收資本額比率
設立資本額	125,000	0.31%
現金增資	13,254,580	33.30%
盈餘轉增資	25,220,023	63.37%
資本公積轉增資	4,422,932	11.11%
可轉換公司債轉換股本	5,810,017	14.60%
註銷庫藏股	(9,032,550)	(22.69)%
合計	39,800,002	100.00%

二、公開說明書之分送計劃：

陳列處所：依規定函送有關單位外，另備置本公司以供查閱。

分送及索取方式：親洽本公司索取或透過網路下載(<http://mops.twse.com.tw>)。

三、證券承銷商之名稱、地址、網址及電話：

名稱：合作金庫證券股份有限公司

網址：<http://www.tcfhc-sec.com.tw>

地址：台北市忠孝東路四段 325 號 6 樓

電話：(02)2731-9987

四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：合作金庫商業銀行股份有限公司

網址：<http://www.tcb-bank.com.tw>

地址：台北市長安東路二段 225 號

電話：(02)2173-8888

名稱：中國信託商業銀行股份有限公司

網址：<http://www.ctbcbank.com.tw>

地址：台北市南港區經貿二路 168 號 1 樓

電話：(02)3327-1688

名稱：台新國際商業銀行股份有限公司

網址：<http://www.taishinbank.com.tw>

地址：台北市中山區中山北路二段 44 號

電話：(02)2568-3988

名稱：兆豐國際商業銀行股份有限公司

網址：<http://www.megabank.com.tw>

地址：台北市中正區忠孝東路二段 123 號

電話：(02)2563-3156

名稱：新加坡商星展銀行股份有限公司台北分公司

網址：<http://www.dbs.com.sg/index/default.page>

地址：台北市松仁路 32 號 15 樓

電話：(02)6612-8534

名稱：臺灣銀行股份有限公司

網址：<http://www.bot.com.tw>

地址：台北市中正區重慶南路一段 120 號

電話：(02)2349-3456

名稱：彰化商業銀行股份有限公司

網址：<http://www.bankchb.com.tw>

地址：台北市中山區中山北路二段 57 號

電話：(02)2536-2951

名稱：玉山商業銀行股份有限公司

網址：<http://www.esunbank.com.tw>

地址：台北市松山區民生東路三段 117 號

電話：(02)2719-1313

名稱：第一商業銀行股份有限公司

網址：<http://www.firstbank.com.tw>

地址：台北市重慶南路一段 30 號

電話：(02)2348-1111

名稱：臺灣中小企業銀行股份有限公司

網址：<http://www.tbb.com.tw>

地址：台北市大同區塔城街三十號

電話：(02)2559-7171

五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：永豐商業銀行股份有限公司

網址：<http://bank.sinopac.com>

地址：台北市南京東路三段三十六號

電話：(02)2517-3336

六、股票或公司債簽證機構：因採無實體發行，無簽證機構。

七、辦理股票過戶機構：

名稱：華邦電子股份有限公司股務辦事處

網址：<http://stock.walsin.com>

地址：台北市內湖區行善路 398 號 8 樓

電話：(02) 2790-5885

八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：余鴻賓會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：台北市信義區松仁路100號20樓

網址：<http://www.deloitte.com.tw>

電話：(02)2725-9988

律師姓名：徐心蘭律師
事務所名稱：理律法律事務所
地址：台北市松山區敦化北路201號7樓 網址：<http://www.leeandli.com> 電話：(02)2715-3300

十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：余鴻賓、吳恪昌會計師
事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所
地址：台北市信義區松仁路100號20樓 網址：<http://www.deloitte.com.tw> 電話：(02)2725-9988

十一、公司債複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用。

十二、本公司發言人、代理發言人：

發言人

姓名：黃求己

職稱：營運管理中心 副總經理

電話：(03)567-8168

電子郵件信箱：CCHuan15@winbond.com

代理發言人

姓名：溫萬壽

職稱：記憶 IC 製造事業群 執行副總經理

電話：(03)567-8168

電子郵件信箱：WSWen@winbond.com

姓名：蘇源茂

職稱：董事長室 副董事長兼副執行長

電話：(03)567-8168

電子郵件信箱：YMSU@winbond.com

十三、公司網址：<https://www.winbond.com>

目 錄

	<u>頁次</u>
壹、公開說明書摘要及發行人基本資料.....	1
貳、發行辦法.....	2
參、資金用途.....	3
肆、附件.....	16
一、證券承銷商總結意見	
二、證券承銷商出具之承銷手續費之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等聲明書	
三、本次發行之董事會議事錄	

註：依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第二十條，發行人申報發行普通公司債，如銷售對象僅限櫃買中心國際債券管理規則所定之專業投資人者，所檢具之公開說明書編製內容，應依公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則第六條第三項規定辦理。前項公司債之公開說明書應揭露證券承銷商總結意見及證券承銷商出具之承銷手續費之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等聲明書。

壹、公開說明書摘要及發行人基本資料

華邦電子股份有限公司公開說明書摘要

實收資本額：39,800,001,930 元		公司地址：台中市大雅區中部科學工業園區科雅一路 8 號		電話：(04)2521-8168	
設立日期：76 年 09 月 29 日			網址：http://www.winbond.com		
上市日期：84 年 10 月 18 日		上櫃日期：不適用		公開發行日期：77 年 03 月 02 日	
		管理股票日期：不適用			
負責人：董事長 焦佑鈞 總經理 詹東義		發言人姓名：黃求己 代理發言人姓名：溫萬壽 蘇源茂		職稱：副總經理 職稱：執行副總經理 職稱：副董事長兼副執行長	
股票過戶機構：華邦電子股份有限公司股務辦事處			電話：(02)2790-5885 網址：http://stock.walsin.com 地址：台北市內湖區行善路 398 號 8 樓		
股票承銷機構：不適用		電話：不適用		地址：不適用	
		網址：不適用			
公司債承銷機構		電話		網址	
合作金庫證券股份有限公司		(02)2731-9987		http://www.tcfhc-sec.com.tw	
		地址		地址	
		台北市忠孝東路四段 325 號 6 樓			
最近年度簽證會計師：勤業眾信聯合會計師事務所			電話：(02)2725-9988 網址：http://www.deloitte.com.tw		
最近年度簽證會計師：余鴻賓、吳恪昌會計師			地址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓		
複核律師：不適用		電話：不適用		地址：不適用	
		網址：不適用			
信用評等機構：不適用		電話：不適用		地址：不適用	
		網址：不適用			
評等標的		發行公司：不適用		無 <input type="checkbox"/> ； 有 <input type="checkbox"/> ，評等日期：不適用	
		本次發行公司債：不適用		無 <input type="checkbox"/> ； 有 <input type="checkbox"/> ，評等日期：不適用	
				評等等級：不適用	
				評等等級：不適用	
董事選任日期：106 年 6 月 13 日，任期：3 年			監察人選任日期：不適用(本公司採審計委員會制)		
全體董事持股比例：24.13% (107 年 5 月 31 日)			全體監察人持股比率：不適用		
董事、監察人及持股超過 10% 股東及其持股比例：(107 年 5 月 31 日)					
職稱	姓	名	持股比例	職稱	姓
董事長	焦佑鈞		1.59%	董事	林之晨
副董事長	蘇源茂		0.02%	董事	馬維欣
董事	苗豐強		0.00%	獨立董事	蔡豐賜
董事	靳蓉		0.30%	獨立董事	徐善可
董事	華新麗華股份有限公司		22.21%	獨立董事	許介立
	(代表人：潘思如)			獨立董事	張善政
					0.00%
工廠地址：台中市大雅區中部科學工業園區科雅一路 8 號			(04)2521-8168		
主要產品：積體電路、各種半導體零組件及其他系統產品之研究開發、生產及銷售			市場結構(106 年度)：外銷 77.78%；內銷 22.22 %		
風險事項：不適用					
去 (1 0 6) 年 度		合併營業收入：47,591,792 仟元、合併稅前純益：7,097,529 仟元、每股盈餘：1.54 元			
本次募集發行有價證券種類及金額		本次募集發行種類為一〇七年度第一次有擔保普通公司債，發行金額為新臺幣壹佰億元整，請參閱本公開說明書封面			
發行條件		固定年利率 1%，自發行日起，於每屆滿周年之日依票面利率每一年單利計、付息一次；到期一次還本；擔保方式為有擔保普通公司債；債券型式採無實體發行，請參閱本公開說明書封面			
募集資金用途及預計產生效益概述		本次發行有擔保普通公司債係用於支付資本支出、償還銀行借款及充實營運資金，可提升現有產能並轉換先進製程以達成經濟規模強化公司競爭優勢，以及改善財務結構、降低利息支出及銀行借款依存度，預計產生效益請參閱本公開說明書第參章資金用途。			
本次公開說明書刊印日期：107 年 7 月 4 日			刊印目的：發行一〇七年度第一次有擔保普通公司債		
其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次：請參閱本公開說明書目錄					

貳、發行辦法

- 一、債券名稱：華邦電子股份有限公司一〇七年度第一次有擔保普通公司債（以下簡稱本公司債）。
- 二、發行總額：本公司債發行總額為新臺幣壹佰億元整。
- 三、票面金額：本公司債之票面金額為新臺幣壹佰萬元。
- 四、發行價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。
- 五、發行期限：本公司債發行期限為七年期，自民國 107 年 7 月 17 日發行，至民國 114 年 7 月 17 日到期。
- 六、票面利率：本公司債票面利率為固定年利率 1%。
- 七、還本方式：本公司債自發行日起屆滿七年到期一次還本。
- 八、計付息方式：本公司債自發行日起，於每屆滿周年之日依票面利率每一年單利計、付息一次。每壹佰萬元債券付息至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。
- 九、擔保方式：本公司債由合作金庫商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、新加坡商星展銀行股份有限公司台北分公司、臺灣銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司及臺灣中小企業銀行股份有限公司擔任聯合保證銀行，依簽訂之聯合委任保證合約及履行公司債保證義務合約提供保證。
- 十、承銷方式：將由證券商包銷並以洽商銷售方式對外公開承銷。
- 十一、承銷機構：合作金庫證券股份有限公司。
- 十二、受託人：本公司債由永豐商業銀行股份有限公司為債權人之受託人，以代表債權人之利益行使查核監督本公司履行公司債發行事項之權責，並簽訂受託契約。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途買受者，對於本公司與受託人間受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法均予同意承認並授與有關受託事項之全權代理，此項授權並不得中途撤銷。債權人得在規定營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱受託契約內容。
- 十三、還本付息代理機構：本公司債委託合作金庫商業銀行股份有限公司民生分行代理還本付息事宜，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，由還本付息代理機構製作扣繳憑單，並寄發予債券所有人。
- 十四、通知方式：有關本公司債應通知債權人之事項，除法令另有規定者外，均於公開資訊觀測站（<http://mops.twse.com.tw>）公告或按照臺灣集中保管結算所股份有限公司規定辦理。
- 十五、債券形式：本公司債採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。
- 十六、銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。

參、資金用途

一、本次發行公司債運用計畫分析

(一)資金來源：

- 1.本計畫所需資金總額：新臺幣壹佰億元整。
- 2.資金來源：發行一〇七年度第一次有擔保普通公司債。

(二)本次發行公司債依公司法第248條規定，揭露有關事項及償還款項之募集計畫與保管方法：

- 1.發行公司名稱：華邦電子股份有限公司
- 2.債券名稱：華邦電子股份有限公司一〇七年度第一次有擔保普通公司債（以下簡稱「本公司債」）
- 3.公司債總額及債券每張之面額：本公司債發行總額為新臺幣壹佰億元整，每張票面金額為壹佰萬元整。
- 4.公司債之利率：本公司債票面利率為固定年利率1%。
- 5.公司債償還期限及方法：本公司債自發行日起屆滿七年到期一次還本。
- 6.償還公司債款之籌集計畫及保管方法：
 - (1)本次公司債償債存續期間之償債款項資金來源，將由自有資金、營業收入、銀行借款、貨幣市場、募集公司債或資本市場項下支應。
 - (2)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。
 - (3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。
- 7.公司債募得價款之用途及運用計畫：支付資本支出、償還銀行借款及充實營運資金。
- 8.前已募集之公司債，其未償還之數額：無。
- 9.公司債發行之價格：按票面金額十足發行。
- 10.公司股份總數、已發行股份總數及已實收之金額：截至民國(下同)107年3月31日止，額定股本總額為新臺幣陸佰柒拾億元整(NT\$67,000,000,000元)，已發行股份總數為參拾玖億捌仟萬零壹佰玖拾參股(3,980,000,193股)，每股面額新臺幣壹拾元，實收資本額新臺幣參佰玖拾捌億零壹仟玖佰參拾元整(NT\$39,800,001,930元)。
- 11.公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：截至107年3月31日止，該項餘額為新臺幣陸佰參拾億零參仟柒佰零柒萬參仟元整(NT\$63,037,073仟元)。
- 12.證券管理機關規定之財務報表：不適用。
- 13.公司債權人之受託人名稱及其約定事項：本公司債由永豐商業銀行股份有限公司為債權人之受託人，代表債權人之利益行使查核及監督本公司履行本公司債發行事項之權責，並訂立受託契約。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途買受者，對於本公司與受託人間受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法，均予同意承認並授與有關受託事項之全權代理，此項授權並不得中途撤銷，至於受託契約內容，債權人得在規定營業時

間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。

14.代收款項之銀行或郵局名稱及地址：

(1)代收款項之銀行：合作金庫商業銀行東台北分行。

(2)代收款項銀行地址：台北市忠孝東路四段325號1樓。

15.承銷或代銷機構名稱及約定事項：

(1)承銷機構名稱：合作金庫證券股份有限公司。

(2)約定事項：主要係約定申報生效後之相關對外公開承銷之權利及事務。

16.有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行保證。

17.有發行保證人者，其名稱及證明文件：本公司債由合作金庫商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、新加坡商星展銀行股份有限公司台北分公司、臺灣銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司及臺灣中小企業銀行股份有限公司擔任聯合保證銀行，依簽訂之聯合委任保證合約及履行公司債保證義務合約提供保證。

18.對於前已發行之公司債，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

19.可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。

20.附認股權者，其認購辦法：不適用。

21.董事會之議事錄：詳107年4月24日董事會議事錄。

22.公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。

(三)本次計劃之可行性、必要性及合理性，及各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年每股盈餘稀釋影響

1.本次發行公司債之可行性評估：

本次公司債之計畫發行總額為新臺幣10,000,000仟元，每張面額為新臺幣1,000仟元，按面額發行。本次計畫發行辦法係參酌資本市場接受度及公司未來營運狀況訂定，且本次發行普通公司債之承銷方式係採承銷團全數餘額包銷並以洽商銷售方式對外公開承銷，應可確保完成本次資金募集，故本次募集資金計畫應屬可行。

2.本次發行公司債之必要性評估：

本次發行普通公司債將多元化籌資管道，目前國內長短期利差仍維持相對低的水準，於未來升息趨勢下，係為發行債券鎖定中長期資金成本的良好時機。此次發行普通公司債之票面利率較預計償還之銀行借款及近期平均借款利率為低，故用以償還銀行借款及支應未來營運成長所需，充實營運資金，將可節省利息支出、降低銀行借款依存度，提升財務調度彈性。

另在資本支出方面，隨著市場對於利基型動態隨機存取記憶體與編碼型快閃記憶體需求持續增加，本公司現有12吋晶圓廠產能不足以供給市場需求，記憶體產業具有資本密集及技術密集度高之進入特性，在市場成長之際，本公司亦規劃持續增加產能及轉換先進製程，以滿足客戶需求。再者，當企業產品產能擴充，可降低產品單位成本，增加銷售價格競爭優勢，強化獲利能

力。12吋晶圓產能擴充可使本公司擴大經濟規模，對於長期營運發展、財務結構之穩固及市場占有率之提升有相當大的助益。

綜上所述，本次發行公司債應屬必要。

3. 本次發行公司債之合理性評估：

本次發行有擔保普通公司債用於支付資本支出、償還銀行借款及充實營運資金，除可降低利率波動風險及銀行借款依存度以保留資金運用彈性，並提升長期資金來源及流動比率以改善財務結構外，本次發行之有擔保普通公司債係固定利率，在利率走揚趨勢下，利息費用亦可適度減輕，故本次發行普通公司債應屬合理。

4. 分析各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響：

(1) 各種籌資工具籌資成本與有利不利因素比較表

綜觀上市（櫃）公司主要資金調度來源，大致分為債權及股權之相關籌資工具，前者有銀行借款、普通公司債及國內外轉換公司債等，後者如現金增資發行新股及海外存託憑證。茲就各種資金調度來源比較分析有利及不利因素如下：

項目	有利因素	不利因素
股		
現金增資發行新股	<ol style="list-style-type: none"> 1.改善財務結構，降低財務風險，提升市場競爭力。 2.係為資本市場較為普遍之金融商品，一般投資者接受程度高。 3.員工依法得優先認購 10%~15%，可提升員工之認同感及向心力。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.每股盈餘易因股本膨脹而被稀釋。 2.對於股權較不集中之公司，其經營權易受威脅。 3.承銷價與市價若無合理差價，則不易籌集成功。
權		
海外存託憑證	<ol style="list-style-type: none"> 1.經由海外市場募集資金，可拓展公司之知名度。 2.籌資對象以國外法人為主，避免國內籌碼膨脹太多，對股價產生不利影響。 3.提高自有資本比率，改善財務結構。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.公司海外知名度及其產業成長性影響資金募集計畫成功與否。 2.固定發行成本較高，為符合經濟規模，發行額度不宜過低。
債		
國內外轉換公司債	<ol style="list-style-type: none"> 1.因其附有「轉換權」，票面利率較長期性借款為低。 2.轉換公司債換成普通股之轉換價格，一般皆高於發行轉換公司債時普通股之時價，發行公司相當於以較高價格溢價發行股票。 3.稀釋每股盈餘之壓力較低。 4.轉換債經債權人請求轉換後，即由負債轉變成資本，除可節省利息支出外，亦可避免到期還本之龐大資金壓力。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.流通性較普通股低。 2.未轉換，仍有贖回之資金壓力。 3.由於轉換公司債之轉換權利屬於債權人，發行公司較難以掌握轉換時點以確認其長期資金調度計畫。
權		

項目	有利因素	不利因素
普通公司債	1.對股權沒有稀釋效果。 2.債權人對公司不具管理權，對公司經營權掌握，不會造成重大影響。 3.有效運用財務槓桿，創造較高之利潤。	1.利息負擔侵蝕公司獲利。 2.公司債期限屆滿後，公司即面臨資金贖回壓力。
銀行借款或發行承兌匯票	1.對股權沒有稀釋效果。 2.債權人對公司不具管理權，對公司經營權掌握，不會造成重大影響。 3.有效運用財務槓桿，創造較高之利潤。	1.利息負擔侵蝕公司獲利。 2.財務結構惡化，降低競爭能力。 3.可能需提供擔保品。 4.到期有還款壓力。

(2)各種資金調度來源對本公司每股盈餘稀釋之影響

本公司此次係以發行普通公司債籌集資金，由上述分析可知，僅發行普通公司債與銀行借款對每股盈餘稀釋並無影響。

- 5.以低於票面金額發行股票者，應說明公司折價發行新股之必要性與合理性、未採用其他籌資方式之原因與其合理性及所沖減資本公積或保留盈餘之數額：不適用。

(四)本次發行價格之訂定方式

本次發行公司債價格參考櫃買中心公佈之殖利率曲線與同年期利率交換合約，並依據投資人對未來利率判斷後審慎定價。

(五)資金運用概算及可能產生之效益：

- 1.如為收購其他公司、擴建或新建不動產、廠房及設備者：

本公司預計購置機器設備4,000,000仟元，其中2,000,000仟元以此次公司債募得資金支應，另2,000,000仟元則以自有資金或銀行借款為資金來源，此次增購為12吋晶圓記憶體相關生產設備，本次購置之機器設備係用以提升現有產能及轉換先進製程，將分批安裝及導入，預計於108年1月開始量產。預計可能產生之增額效益如下表所示：

單位：仟片；新臺幣仟元

年度	產品別	生產量	銷售量	銷售值	營業毛利	營業利益
108年	12吋晶圓	36	18	1,448,482	196,731	(100,426)
109年	12吋晶圓	36	36	2,888,625	736,246	216,293
110年	12吋晶圓	36	36	2,869,094	1,023,467	507,030
111年	12吋晶圓	36	36	2,670,418	943,163	462,488
112年	12吋晶圓	36	36	2,485,556	869,349	421,949

註：係以本次產能擴充計畫全數機器設備投資4,000,000仟元之產能為估計基礎。

本次購置之機器設備預估108~113年可增加之生產量係以主要銷售產品規格及因應未來市場需求而估計，並考量機台投入量產時點與設備產能推估而得；另考量目前產能利用情形與市場供需狀況及產品未來成長性，並依過去實際投產到可供銷售所需時間做為推估假設，以產銷一致之基礎估計銷售

量，故108年銷量略低於生產量；銷售值係依據估計銷售量與單位價格估算，單位價格係考量目前市場價格、市場需求持續成長等因素；而營業毛利及營業利益之生產成本估算係評估主要成本組成要素，如原料晶圓之價格、新購置設備耐用年限的合理攤銷折舊額、公司人力成本的變動及生產所需物料、水電等製造費用後估算而得。經評估上述生產成本、新購設備影響之現金流入數、製程改善成本節省及參考目前實際運轉之產線成本推估，本公司本次計畫預計可增加之營業毛利及營業利益應屬合理。

而預估資金回收年限，係依據預計增加之營業利益加回本次計畫所提列之折舊費用所累計現金流量估算而得，故預計資金回收年數約為5年，應屬合理。

單位：新臺幣仟元

年度	營業利益	折舊費用	現金流入	累計現金流入
108年	(100,426)	502,736	402,310	402,310
109年	216,293	502,736	719,029	1,121,339
110年	507,030	502,736	1,009,766	2,131,105
111年	462,488	502,736	965,224	3,096,329
112年	421,949	502,736	924,685	4,021,014

註：係以本次產能擴充計畫全數機器設備投資4,000,000仟元為估計基礎。

2.如為轉投資其他公司者：

(1)轉投資事業最近二年度之稅後淨利、轉投資之目的、資金計畫用途及其所營事業與公司業務之關聯性、預計投資損益情形及對公司經營之影響：不適用。

(2)如轉投資特許事業者應敘明特許事業主管機關核准或許可情形及核准或許可之附帶事項是否有影響本次募集與發行有價證券：不適用。

3.如為充實營運資金、償還債務者：

(1)公司債務逐年到期金額、償還計畫及預計財務負擔減輕情形、目前營運資金狀況、所需之資金額度及預計運用情形，並列示所編製之申報年度及未來一年度各月份之現金收支預測表：

A.公司債逐年到期金額：

單位：新臺幣仟元

公司債名稱		到期年月	到期金額
普通公司債	一〇七年度第一次有擔保普通公司債 (預計107年7月發行)	114年7月	10,000,000

B.償還債務計劃及預計財務負擔減輕情形：

本次募集資金計畫，預計於107年第三季募集完成，募集資金總額新臺幣10,000,000仟元，其中償還銀行借款計新臺幣1,961,760仟元，以擬償還之銀行借款利率扣除本公司債之票面利率1%設算，預計107年可節省利息支出約新臺幣964仟元，以後每年預計可節省利息支出約新臺幣16,674仟元，並可改善財務結構，降低對銀行之依存度，增加資金調度彈性。

單位：新臺幣仟元

貸款機構	利率 (%)	契約期間	原貸款用途	原貸款金額	107年第四季償還金額	107年度減少利息(註)	以後每年度減少利息(註)
中信聯貸	1.89%	103/07/07-108/11/27	資本支出	9,000,000	1,300,000	964	11,570
臺銀借款	1.59%	103/12/29-110/12/29	資本支出	617,600	61,760	—	364
臺銀聯貸	1.79%	105/08/15-110/12/29	償還金融機構負債暨充實中期營運週轉金	12,000,000	600,000	—	4,740
合計				21,617,600	1,961,760	964	16,674

註：假設預計於107年第四季償還金融機構借款，扣除本公司債票面利率1%後，設算可節省之利息差額。

其餘新臺幣6,038,240仟元於第三季資金募集完成後，即可用於充實營運資金，若依本公司平均借款利率1.84%扣除本公司債票面利率1%後設算，預計107年度可節省利息支出約新臺幣12,680仟元，以後每年預計可節省利息支出約新臺幣50,721仟元。

綜上所述，本次發行七年長天期固定利率債券，可降低未來利率上升造成本公司利息費用支出提高之風險，並可減少銀行借款動用額度以保留資金運用靈活度，以增加本公司經營之應變能力及降低企業經營之財務風險。

C.目前營運資金狀況：

本公司至107年5月31日止，帳上現金及約當現金為新臺幣6,336,358仟元，流動資產扣除流動負債之餘額為新臺幣19,503,795仟元(個體自結數)。

D.所需之資金額度及運用情形：

(A)本次計畫之總資金運用計畫

單位：新臺幣仟元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度		
			107年度		108年度
			第三季	第四季	第一季
支付資本支出	108年第一季	4,000,000	1,000,000	2,300,000	700,000
償還銀行借款	107年第四季	1,961,760	—	1,961,760	—
充實營運資金	107年第三季	6,038,240	6,038,240	—	—
合計		12,000,000	7,038,240	4,261,760	700,000

(B)本次籌資之資金運用計畫

單位：新臺幣仟元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度	
			107年度	
			第三季	第四季
支付資本支出	107年第四季	2,000,000	1,000,000	1,000,000
償還銀行借款	107年第四季	1,961,760	—	1,961,760
充實營運資金	107年第三季	6,038,240	6,038,240	—
合計		10,000,000	7,038,240	2,961,760

本公司本次計畫資金用途為支付資本支出、償還銀行借款及充實營運資金，募得資金取代銀行融資，有助於增進長期資金之穩定性及強化資金靈活運動調度能力。

E.申報年度及未來一年度現金收支預測表：如下頁所示。

107 年度現金收支預測表

單位：新臺幣仟元

項目/月份	1 月份	2 月份	3 月份	4 月份	5 月份	6 月份	7 月份	8 月份	9 月份	10 月份	11 月份	12 月份	合計
期初現金餘額(1)	11,658,134	11,454,840	9,835,422	8,981,720	9,069,966	6,336,358	5,975,882	16,300,545	16,422,636	13,209,490	12,933,176	11,734,493	11,658,134
加：非融資性收入													
應收帳款收現	3,913,048	2,966,231	3,754,087	3,224,628	3,454,270	3,546,514	3,484,469	3,775,177	3,929,739	3,929,739	4,019,509	4,120,369	44,117,780
利息收入	4,190	3,791	4,092	4,956	3,674	3,674	3,674	3,674	3,674	3,674	3,674	3,674	46,421
股利收入					7,888			279,166	366,584				653,638
處分長期投資	8,709				148,609								157,318
合計(2)	3,925,947	2,970,022	3,758,179	3,229,584	3,614,441	3,550,188	3,488,143	4,058,017	4,299,997	3,933,413	4,023,183	4,124,043	44,975,157
減：非融資性支出													
應付帳款及費用付現 (不含薪資)	1,775,473	1,855,633	1,891,516	1,561,402	2,264,700	1,892,130	1,936,587	2,032,178	2,058,586	2,089,078	2,143,877	2,242,438	23,743,598
薪資費用	458,685	250,892	270,977	560,099	375,934	506,169	595,411	325,932	536,920	252,290	258,960	575,823	4,968,092
利息費用	19,346	17,388	18,879	18,125	18,415	18,309	35,426	35,426	35,426	35,426	33,201	32,068	317,435
長期投資				109,292									109,292
資本支出	1,886,164	1,901,561	2,430,509	892,420	2,389,000	1,432,296	596,056	1,542,390	902,211	1,832,933	1,485,828	1,905,046	19,196,414
發放股利									3,980,000				3,980,000
合計(3)	4,139,668	4,025,474	4,611,881	3,141,338	5,048,049	3,848,904	3,163,480	3,935,926	7,513,143	4,209,727	3,921,866	4,755,375	52,314,831
要求最低現金餘額(4)	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
所需資金總額(5)=(3)+(4)	10,139,668	10,025,474	10,611,881	9,141,338	11,048,049	9,848,904	9,163,480	9,935,926	13,513,143	10,209,727	9,921,866	10,755,375	58,314,831
融資前可供支用現金餘額(短絀) (6)=(1)+(2)-(5)	5,444,413	4,399,388	2,981,720	3,069,966	1,636,358	37,642	300,545	10,422,636	7,209,490	6,933,176	7,034,493	5,103,161	(1,681,540)
融資淨額													
發行新股													
中短期借還款淨額	10,427	(563,966)											(553,539)
發行公司債							10,000,000						10,000,000
長期融資還款					(1,300,000)	(61,760)					(1,300,000)	(661,760)	(3,323,520)
合計(7)	10,427	(563,966)			(1,300,000)	(61,760)	10,000,000				(1,300,000)	(661,760)	6,122,941
期末現金餘額(8)=(1+2-3+7)	11,454,840	9,835,422	8,981,720	9,069,966	6,336,358	5,975,882	16,300,545	16,422,636	13,209,490	12,933,176	11,734,493	10,441,401	10,441,401

108 年度現金收支預測表

單位：新臺幣仟元

項目/月份	1 月份	2 月份	3 月份	4 月份	5 月份	6 月份	7 月份	8 月份	9 月份	10 月份	11 月份	12 月份	合計
期初現金餘額(1)	10,441,401	9,862,764	10,459,373	10,877,412	11,654,587	11,390,710	16,536,284	17,208,922	18,945,168	17,728,104	19,519,967	20,128,359	10,441,401
加：非融資性收入													
應收帳款收現	4,120,369	3,868,001	3,585,621	3,588,093	3,739,934	3,910,229	3,912,701	4,071,947	4,250,560	4,394,844	4,353,752	4,452,736	48,248,787
利息收入	3,674	3,674	3,674	3,674	3,674	3,674	3,674	3,674	3,674	3,674	3,674	3,674	44,088
股利收入								279,166	366,584				645,750
處分長期投資													0
合計(2)	4,124,043	3,871,675	3,589,295	3,591,767	3,743,608	3,913,903	3,916,375	4,354,787	4,620,818	4,398,518	4,357,426	4,456,410	48,938,625
減：非融資性支出													
應付帳款及費用付現 (不含薪資)	1,900,363	2,164,972	2,251,802	1,881,938	1,930,680	2,239,625	2,504,440	2,064,081	2,099,427	1,868,751	1,920,787	3,730,491	26,557,357
薪資費用	422,767	422,360	421,676	459,544	456,544	456,311	458,565	489,811	472,551	478,828	475,447	475,989	5,490,393
利息費用	32,068	32,068	32,068	32,068	29,843	38,296	158,296	38,296	38,296	38,296	36,071	32,884	538,550
長期投資													0
資本支出	2,347,482	655,666	465,710	441,042	290,418	972,337	122,436	26,353	27,608	220,780	16,729	20,780	5,607,341
發放股利									3,200,000				3,200,000
合計(3)	4,702,680	3,275,066	3,171,256	2,814,592	2,707,485	3,706,569	3,243,737	2,618,541	5,837,882	2,606,655	2,449,034	4,260,144	41,393,641
要求最低現金餘額(4)	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
所需資金總額(5)=(3)+(4)	12,202,680	10,775,066	10,671,256	10,314,592	10,207,485	11,206,569	10,743,737	10,118,541	13,337,882	10,106,655	9,949,034	11,760,144	48,893,641
融資前可供支用現金餘額(短絀) (6)=(1)+(2)-(5)	2,362,764	2,959,373	3,377,412	4,154,587	5,190,710	4,098,044	9,708,922	11,445,168	10,228,104	12,019,967	13,928,359	12,824,625	10,486,385
融資淨額													
發行新股													
中短期借還款淨額													
長期融資撥款						5,600,000							5,600,000
長期融資還款					(1,300,000)	(661,760)					(1,300,000)	(1,861,760)	(5,123,520)
合計(7)					(1,300,000)	4,938,240					(1,300,000)	(1,861,760)	476,480
期末現金餘額(8)=(1+2-3+7)	9,862,764	10,459,373	10,877,412	11,654,587	11,390,710	16,536,284	17,208,922	18,945,168	17,728,104	19,519,967	20,128,359	18,462,865	18,462,865

(2)就公司申報年度及預計未來一年度應收帳款收款與應付帳款付款政策、資本支出計畫、財務槓桿及負債比率(或自有資產與風險性資產比率)，說明償債或充實營運資金之原因

A.應收帳款收款及應付帳款付款政策

本公司主要收入來源為銷售利基型動態隨機存取記憶體及編碼型快閃記憶體，平均授信期間為月結 30 天~60 天；係考量客戶之信用狀況、營運規模及交易頻率等因素後，予以適當授信額度及收款條件，每月應收款項收現係以本公司 107 年實際收款天數為編製基礎，參考最近 107 年 1~5 月實際收款期間，再考量本公司之出貨、收款狀況，作為 107~108 年各月份現金流入之估算基礎，故其編製基礎尚屬合理。

本公司採購係以原、物料為主，依廠商規模、性質及市場行情而有差異，供應商採電匯、開立即期(遠期)支票或透過銀行系統開立信用狀(L/C)方式進行付款，本公司所編製 107 及 108 年度現金收支預測表所採之應付帳款付現天數，係參酌目前的付款政策與公司實際經營情形為編製基礎，故其編製基礎尚屬合理。

B.資本支出及長期投資計畫

本公司 107 及 108 年度資本支出分別為 19,196,414 仟元及 5,607,341 仟元，合計為 24,803,755 仟元，係用以購置 12 吋晶圓生產、研發設備及提升先進製程產能，資金來源包含 106 年度辦理現金增資募得資金 8,800,000 仟元、此次發行普通公司債 2,000,000 仟元外，餘將由自有資金及銀行借款支應，預計將可維持市場競爭力及提升產品品質，進而提升獲利。

本公司 107 年 4 月長期投資係為增加集團持股比率，以自有資金增加投資 109,292 仟元。

C.財務槓桿及負債比率

項目	106.12.31	107.12.31(預計)	108.12.31(預計)
財務槓桿度(倍)	1.01	1.02	1.05
負債比率(%)	28.66%	30.57%	28.05%

資料來源:106 年度經會計師查核簽證之個體財務報告；107 及 108 年度係本公司自行推估。

財務槓桿指數係衡量公司舉債經營之財務風險，用以評估利息費用之變動對於營業利益之影響程度，該項指標數值愈高表示公司所承擔之財務風險愈大，若公司未舉債經營，則其財務槓桿度為 1，數值越大財務風險越高，而本指數若為正數，顯示舉債經營仍屬有利。透過本次發行普通公司債，自資本市場取得長期資金，將可適度減輕財務負擔，進而強化財務結構，加上所募資金部分用以償還銀行借款及充實營運資

金，可節省相關銀行借款利息支出，故對本公司之財務槓桿度應有正面之影響。

另就負債比率而言，本次發行普通公司債，自資本市場取得長期資金部分用於償還銀行借款，預期將提高 107 年度之負債比率，惟將有助於提升流動比率及速動比率。

綜上，本次發行公司債用以支付資本支出、償還銀行借款及充實營運資金，主要考量係發行中長期公司債可強化財務結構；此外，考量目前中長期公司債發行利率仍處低檔，此時發行以新臺幣計價之公司債，不僅無匯率風險，亦可固定長期資金成本，對本公司長期營運發展具正面助益，故該資金募集計畫實屬合理必要。

- (3)增資計畫如用於償債者，應說明原借款用途及其效益達成情形。若原借款係用以購買營建用地、支付營建工程款或承攬工程，應就預計自購買該營建用地至營建個案銷售完竣或承攬工程完竣所需之資金總額、不足資金之來源及各階段資金投入及工程進度，說明原借款原因，並就認列損益之時間點、金額說明預計可能產生效益及其達成情形：

A.原借款用途之必要性及合理性

單位：新臺幣仟元

貸款機構	利率 (%)	契約期間	原貸款用途	原貸款金額	107 年第四季償還金額	107 年度減少利息 (註)	以後每年度減少利息 (註)
中信聯貸	1.89%	103/07/07-108/11/27	資本支出	9,000,000	1,300,000	964	11,570
臺銀借款	1.59%	103/12/29-110/12/29	資本支出	617,600	61,760	—	364
臺銀聯貸	1.79%	105/08/15-110/12/29	償還金融機構負債暨充實中期營運週轉金	12,000,000	600,000	—	4,740
合 計				21,617,600	1,961,760	964	16,674

註：假設預計於 107 年第四季償還金融機構借款，扣除本公司債票面利率 1%後，設算可節省之利息差額。

本公司本次辦理普通公司債 10,000,000 仟元，其中 1,961,760 仟元用以償還銀行借款，原借款用途係支應資本支出及償還金融機構借款所需。

本公司為專業記憶體製造商，所生產之記憶體在技術層次及市場佔有率皆處重要地位，本公司擁有組織化、系統化之供應鏈管理機制，且智慧型裝置、車用電子及物聯網等新興領域產品推陳出新，使記憶體市場需求持續成長；若以擬償還之銀行借款利率扣除本公司債之票面利率 1%設算，預計 107 年可節省利息支出約新臺幣 964 仟元，以後每年預計可節省利息支出約新臺幣 16,674 仟元，此外，近年來各種電子裝置因功能亦趨豐富，所需儲存之程式碼也隨之增加，故每裝置所搭載的

記憶體容量亦有增加的趨勢，且為維持公司一定營運規模產生之營運資金及資本支出需求而向金融機構舉借，確有其必要性及合理性。

B.原借款用途產生之效益

單位：新臺幣仟元

項目	105 年度	106 年度	增(減)
營業收入	33,534,343	38,102,813	4,568,470
營業利益	2,969,794	5,710,689	2,740,895
稅前淨利	3,371,230	6,652,368	3,281,138

資料來源：經會計師查核簽證之個體財務報告

本公司 106 年度營業收入、營業利益及稅前淨利均較 105 年度提升，在大數據發展趨勢，汽車電子及工業控制等新興應用多元發展下，每人持有之電子裝置將持續增加，每單位裝置乘載的記憶體容量亦有提升空間，記憶體之中、長期需求仍持續成長，整體而言，所產生之效益尚屬合理。

- (4)現金收支預測表中，未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本次募資金額百分之六十者，應敘明其必要性、預計資金來源及效益：

本次募資計畫預計於 7 月完成，本公司 107 年 8~12 月及 108 年度資本支出分別為 7,668,408 仟元及 5,607,341 仟元，合計為 13,275,749 仟元，已達本次募集金額 60%。資本支出係用以購置 12 吋晶圓生產、研發設備及提升先進製程產能，資金來源除 106 年度辦理現金增資募得資金 8,800,000 仟元、此次發行普通公司債之 2,000,000 仟元外，餘將由自有資金及銀行借款支應。

本公司主要產品為利基型動態隨機存取記憶體和編碼型快閃記憶體，除持續開發低功耗、高速度以及資訊安全等附加價值創新產品之外，本公司也致力於開發新的製程，持續維持產品的競爭力。利基型動態隨機存取記憶體需求隨著資料中心與電子終端產品需求量與搭載容量提升而增加。而編碼型快閃記憶體隨近年來各項裝置功能智慧和豐富化，應用領域愈趨廣泛；此外，近年來各種電子裝置因功能亦趨豐富，所以儲存之程式碼也隨之增加，皆帶動編碼型快閃記憶體需求。記憶體產業具有資本密集及技術密集高之進入特性，12 吋晶圓產能擴充可使本公司擴大經濟規模，對於長期營運發展、財務結構之穩固及市場占有率之提升有相當大之助益，故此次資本支出有其必要性，亦可達到本公司維持市場競爭力及提升產品品質，進而增進獲利之效益。

- 4.如為購買營建用地、支付營建工程款或承攬工程者，應詳列預計自購買土地至營建個案銷售完竣或承攬工程完竣所需之資金總額、不足資金之來源及各階段資金投入及工程進度，並就認列損益之時點、金額說明預計可能產生效

益：不適用。

5.如為購買未完工程並承受賣方未履行契約者，應列明買方轉讓理由、受讓價格決定依據及受讓過程對契約相對人權利義務之影響：不適用。

二、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項：不適用。

三、本次併購發行新股應記載事項：不適用。

承銷商總結意見

(發行普通公司債委託證券承銷商對外公開銷售且銷售對象僅限專業投資人者適用)

華邦電子股份有限公司本次為發行一〇七年度第一次有擔保普通公司債 10,000 張，每張面額新台幣 1,000,000 元，發行總金額新台幣 10,000,000,000 元並委託本承銷商對外公開銷售，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出申報，業依規定填報案件檢查表，並經本承銷商採取必要程序予以複核，特依「證券商管理規則」及「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，出具本承銷商總結意見。

依本承銷商之意見，華邦電子股份有限公司本次募集與發行普通公司債委託證券承銷商對外公開銷售符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」及相關法令之規定，暨其計畫具可行性及必要性，其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性。

此致

華邦電子股份有限公司

合作金庫證券股份有限公司

負責人：胡 富 雄

承銷部門主管：曾 郁 芬



中 華 民 國 一 〇 七 年 七 月 四 日

聲明書

本公司受華邦電子股份有限公司（下稱華邦電子公司）委託，擔任華邦電子公司募集與發行一〇七年度第一次有擔保普通公司債案乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、華邦電子公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：合作金庫證券股份有限公司



負責人：胡富雄



中 華 民 國 一 〇 七 年 七 月 四 日



華邦電子股份有限公司
第十一屆第七次董事會議事錄(摘錄)

時間：中華民國 107 年 4 月 24 日（星期二）下午 5 時正。

地點：臺北市信義區松智路 1 號 26 樓 2601 室(華新麗華大樓)。

主席：焦佑鈞



記錄：范祥雲



出席董事：焦佑鈞、蘇源茂、苗豐強、靳蓉、蔡豐賜、徐善可、許介立、張善政、馬維欣、
林之晨、潘思如，計 11 人。

請假董事：無。

缺席董事：無。

列席：余鴻賓會計師、總經理詹東義、財務中心主管黃求己及稽核主管阮妙芳。

報告

本公司設董事 11 人，按公司法第 206 條規定，董事會之決議，除本法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之，截至下午 5 時為止，出席董事計 11 人，已逾過半數董事之出席，請主席宣佈開會。

一、宣佈開會

主席宣佈開會。

二、報告事項：略。

三、討論事項：

(一) 上次會議保留之討論事項：無。

(二) 本次會議討論事項：

第一案：略。

第二案

財務處 提

案由：本公司擬發行民國 107 年度第一次有擔保普通公司債，提請 核議案。

說明：一、依本公司章程第 17 條第 16 款規定辦理。

二、本公司為支付資本支出、償還銀行借款及充實營運資金，擬發行民國 107 年度第一次有擔保普通公司債，主要發行條件如下：

(一) 債券名稱：華邦電子股份有限公司民國 107 年度第一次有擔保普通公司債。

(二) 發行總額及面額：發行總額以不超過新台幣壹佰億元整為限，每張面額新台幣壹佰萬元整，採無實體發行。實際募集與發行金額，授權董事長於上述額度內，視市場狀況決定之。

(三) 發行價格：依票面金額十足發行。

(四) 發行期間：7 年期。

(五) 票面利率：採固定年利率發行，以不超過 1.3% 為原則。

(六) 付息方式：自發行日起，按票面利率每年單利計、付息乙次。

(七) 還本方式：本公司債到期一次還本。

(八) 擔保方式：擬洽銀行提供保證以為本公司債之擔保，授權董事長與銀行洽商一切有關條件並處理相關事宜。

(九) 承銷方式：委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷。

(十) 承銷或代銷機構：授權董事長處理相關事宜。

(十一) 受託機構：授權董事長處理相關事宜。

三、上述發行條件如有變更，連同其他發行事宜、相關機構之選擇、取得銀行保證額度，授權董事長依市場狀況決行之，本次發行普通公司債依證券交易法第 8 條規定得不印製實體債券，並於呈報主管機關申報生效後，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。

四、為配合本公司民國 107 年度第一次有擔保普通公司債發行作業（含取得銀行保證額度），擬授權董事長及其指定之人代表本公司簽署一切有關發行前述公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理一切相關發行事宜。

五、本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長及其指定之人全權處理之，提請 決議。

決議：本案進行討論前，列席人員均已離席。經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第三案~第十一案：略。

四、臨時動議：無。

五、散會。（下午 6 時）

華邦電子股份有限公司



董事長：焦佑鈞

